



SiC、GaN、ダイヤモンドその他ワイドバンドギャップ半導体
SiC, GaN, Diamond and other Wide Band Gap Semiconductors

出展のご案内

先進パワー 半導体ウエハ 加工技術展 2027

Advanced Power Semiconductor Wafer Machining Expo



2027.
3.10 (水) ▶ 3.12 (金)

10:00-17:00 幕張メッセ



メルマガの登録はこちら

主催／日本工業出版 産経新聞社
www.sicgan-expo.jp

ご挨拶

このたび、「先進パワー半導体ウエハ加工技術展 2027」を、2027年3月10日(水)から12日(金)までの3日間、千葉県・幕張メッセにて、研削加工の専門技術展「GTJ2027」と同時開催いたします。

本展示会は、次世代パワー半導体であるSiC(シリコンカーバイド)およびGaN(窒化ガリウム)、ダイヤモンド等のウエハ加工に関する最先端技術とソリューションが一堂に集結する、国内最大級の専門展示会です。スライシング、研削、ラッピング、CMP、洗浄、検査・評価、装置・材料など、ウエハ製造工程の全フェーズにわたる最新技術と製品が紹介されます。

前回の「SiC, GaN加工技術展」では、初開催にもかかわらず、多くの皆様にご出展・ご来場いただき、盛況のうちに終了いたしました。

第2回目となる今回は、出展対象をSiC, GaNに加えて、ダイヤモンドや酸化ガリウム(Ga_2O_3)、その他の最先端WBG(ワイドバンドギャップ)半導体材料にまで拡大いたします。そこで展示会の名称も「SiC, GaN加工技術展」から「先進パワー半導体ウエハ加工技術展」に変更し、新たに出発いたします。さらに、従来のウエハメイク工程(スライス、研削、研磨など)に加えて、デバイス製造工程における加工技術(ダイシング、バックグラインディング、プラナリゼーションCMPなど)も対象とすることで、出展社・来場者のさらなる拡大を目指します。

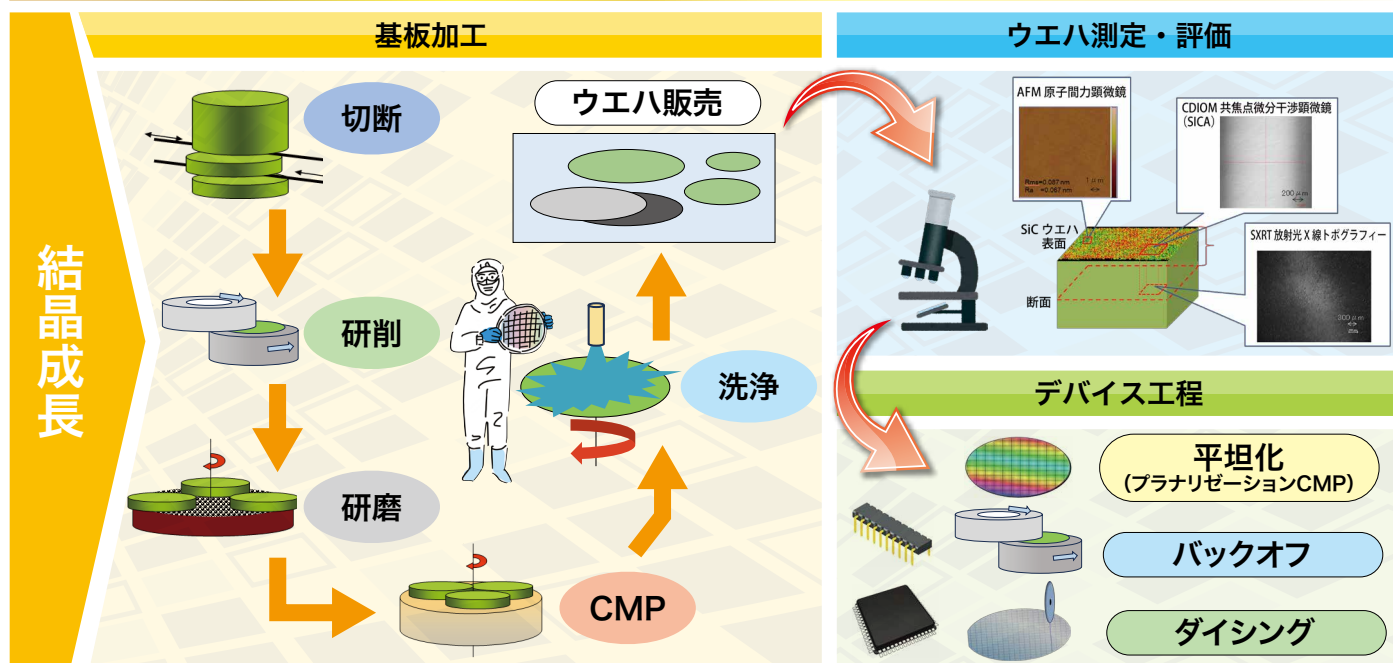
開催概要

名 称	先進パワー半導体ウエハ加工技術展 2027
主 催	日本工業出版(株) (株)産経新聞社
会 期	2027年3月10日(水)～12日(金) 10:00～17:00
会 場	幕張メッセ 7-8ホール(予定) 〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1 Tel. 043-296-0001 https://www.m-messe.co.jp
入 場 料	2,000円(ただし招待券持参者・インターネットからの事前登録者は無料)
特別協力	公益社団法人砥粒加工学会、公益社団法人応用物理学会 先進パワー半導体分科会(予定)
協 賛	日本工作機械工業会、日本工作機械輸入協会、日本工作機械販売協会、日本鍛圧機械工業会、日本精密機械工業会、日本機械工具工業会、日本工作機器工業会、日本精密測定機器工業会、研削砥石工業会、ダイヤモンド工業協会、日本光学測定機工業会、日本フルードパワー工業会、日本歯車工業会、日本機械鋸・刃物工業会、精密工学会、日本フルードパワーシステム学会、ターボ機械協会、SiC アライアンス、GaNコンソーシアム、つくばパワーエレクトロニクスコンステレーション(TPEC)(予定)
出展対象	先進パワー半導体ウエハ関連加工装置(スライシング、研削・研磨、ラッピング、ポリシング、CMP、ベベリングなど)、関連工具・資材(砥石、研磨パッド、研磨スラリー)、ウエハ洗浄装置、ウエハ測定・評価装置
来場対象	先進パワー半導体単結晶成長技術者・研究者、先進パワー半導体ウエハ加工技術者・研究者、先進パワー半導体ウエハ評価技術者・研究者、学生、他

同時開催 「Grinding Technology Japan 2027」

- 出展対象** 研削盤、研磨盤、砥石、ソルーイング装置、計測機器、周辺機器、研削工具、工具研削盤、切削工具、切削工具製造技術、切削工具活用技術、切削油、切削油供給装置、切削油ろ過装置、他
- 来場対象** 研削加工技術者・研究者、工具製造者、研削加工業者、学生、他

先進パワー半導体ウエハ加工技術展 展開イメージ



早期申込締切 **2026年5月29日(金)まで**

申込締切 **2026年9月30日(水)**

出展要項

Aタイプ

出展小間規格

1小間=9㎡(間口3.0m×奥行3.0m×高さ2.7m) 側壁・後壁のみ設置(角小間は側壁なし)

出展料

1小間 **440,000円(税込)**

早期申込割引 2026年5月29日(金)までのお申込みで1小間あたり**418,000円(税込)**

一般の10小間を超える申込の場合、下記の割合で出展料を割引します。

10～19小間 出展料金の5%

20小間以上 出展料金の10%

小間形態・装飾高さ制限

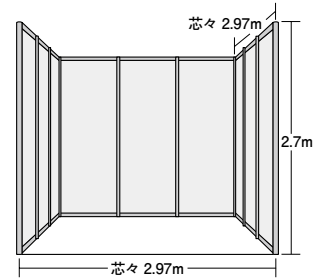
1～3小間 … 並列小間のみ
(高さ：4mまで使用可能※但し、1mセットバックした部分のみ)

4～9小間 … 並列小間、ブロック小間より選択可能
(高さ：4mまで使用可能 ※但し、並列小間は1mセットバック)

10小間以上 … 原則独立小間のみ(高さ：5mまで使用可能)
※4面開放の独立小間となります。並列小間をご希望の場合は事務局までご相談下さい。

開放面の指定

角小間指定対象1、2小間の出展者 指定料金 **55,000円(税込)**



小間のレイアウト

並列



独立ダブル小間
10小間以上



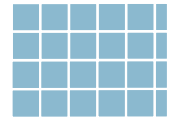
ブロック(ダブル)小間4小間以上



独立トリプル(3小間)小間
12, 15, 18小間のみ



特別アレンジ小間
20小間(180㎡)以上



展示物やブースの設置方法にあわせて、並列・ブロック・独立ダブル・独立トリプル・特別アレンジの5通りの小間アレンジが可能です。

出展料に含まれる費用

基準時間内の会場使用料金・照明・空調費、共有施設の工事費及び維持費、来場者プロモーション費、来場者サービスにかかわる費用(会場案内等の制作)、会場事務局運営・安全管理・警備費用

出展料に含まれない費用

出展者の小間装飾費・搬出入費及び運営費用、電気・ガス・水道等の設備一次幹線工事及び二次側工事と使用料(システムパッケージ申込は別途)、臨時電話等通信回線の架設費用と通信料金、出展機器及び対人傷害などの保険料、会場設備・備品及び他社展示物の破損、紛失弁償費、放置された装飾資材等の残材、ゴミ処分に係る費用、その他、通常出展料に含まない費用とみなされるもの

パッケージ装飾

※詳細・申込については、出展者説明会にてご案内いたします。
※料金は変更になる可能性があります。
※出展料とは別に発生いたします。

小間装飾を簡易に行うためのパッケージプランをご用意いたします。

小間装飾パッケージプラン

- バラベット
- 受付カウンター
- 折りたたみ椅子(1ケ)
- 照明(蛍光灯20W×1+スポットライト15W×2)
- コンセント(2口)一ヶ所(100V-900Wまで使用可能)
- 社名表示
- カーベット
- 名刺受(1ケ)
- 1kW以内の電気幹線工事、使用料含む
- カタログスタンド(A4/12段)(1台)

165,000円(税込) ※出展料は除く



Bタイプ 1社1小間限定

出展小間規格

1小間=間口2.0m×奥行2.0m×高さ2.7m 一定装飾付き(角小間は側壁なし)

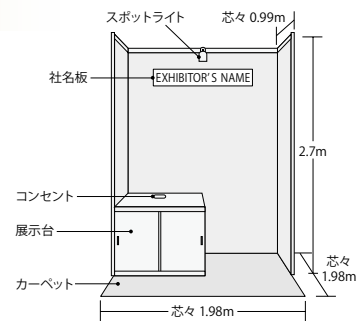
出展料

254,100円(税込) ※出展料、簡易装飾込み

早期申込割引 2026年5月29日(金)までのお申込みで1小間あたり**242,000円(税込)**

出展料に含まれるもの：間口2.0m×奥行2.0mの展示スペース、間仕切り(後壁、側壁1m)、社名板、カーベット、展示台：横幅1.0m×奥行1.0m×高さ0.8m、引き戸ユニット(鍵ナシ)、スポットライト：22W×1、コンセント(アース付100V)：2個口×1,500Wまでの電気幹線工事費・電気使用料

※備品の追加注文がある場合は、別途ご請求させていただきます。詳しい資料は出展者説明会にてお渡しいたします。
※上記基本ディスプレイを使用しない場合も、料金を差引くことはできませんのでご了承ください。



製品・技術発表会

展示会場内の特設セミナースペースで開催する新技術・新製品PRセミナー

日 時：2027年3月10日(水)～12日(金) 10:00～17:00 内で45分間

場 所：展示会場内特設会場(シアター形式 80名定員)

発表料金：1セッション 55,000円(税込)

運営方法：1、聴講無料(各回総入替)

2、受付・進行は発表各社が担当(登録や名刺回収は自由です)

会場設備：受付(机、イス)、聴講席、演台、マイクセット、プロジェクター、スクリーン

P R：案内状、ホームページ等に社名・プログラムを掲載

〈注〉・申込書に20字以内でセミナータイトルを記載下さい。

・終了後は現状復帰をお願いいたします。

・PC使用の場合は各自お持込下さい。※接続テスト等はこちらでご相談下さい

・発表日時は主催者にて決定します。

公式Webサイト バナー広告

貴社のリンクバナーを公式WEB(和・英)に開催1か月前から掲載

掲載期間：2027年2月10日(水)～4月7日(水) ※予定

画像サイズ：W200px × H40px GIF形式 ※アニメーションGIF可

掲載料金：1枠 55,000円(税込)

原稿締切日：2027年1月15日(金) ※リンク先指定の上、完成データをご提出下さい。

開催までのスケジュール(予定)



「SiC,GaN 加工技術展 2025」開催実績

登録来場者数

会 期	Grinding Technology Japan 2025 ／SiC,GaN加工技術展2025	天 候
3月5日(水)	1,786名	雨
3月6日(木)	2,074名	くもり
3月7日(金)	2,664名	晴れ
合 計	6,524名	—

※リピーター(1日に複数来場した人)は1名としてカウント。
※来場者：展示会に来場した方。出展者は含みません。

出展規模

		2025年	
出展者数／小間数		249社・団体・研究室	320小間
内 訳	Grinding Technology Japan2025出展者	126社・団体	264小間
	SiC,GaN加工技術展2025出展者	53社・団体	56小間
砥粒加工学会 研究発表コーナー		24研究室	
砥粒加工学会 卒業研究発表会		29研究室	
砥粒加工学会 賛助会員コーナー		17社	

出展者一覧

アイクリスタル株式会社	セラミックフォーラム株式会社
アミリアジャパン株式会社	つくばパワーエレクトロニクスコンステレーション (TPEC、産業技術総合研究所)
株式会社アライドマテリアル	株式会社東京精密
インサイト株式会社	株式会社東邦銅機製作所
株式会社荏原製作所	日本エクシード株式会社
応用物理学会 先進パワー半導体分科会	日本エンギス株式会社
株式会社オーエステック	日本セララボ株式会社
株式会社岡本工作機械製作所	ノリタケ株式会社
オグラ宝石精機工業株式会社	株式会社バイコウスキージャパン
オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社	浜井産業株式会社
株式会社オプトサイエンス	パルステック工業株式会社
Guangzhou Summit Crystal Semiconductor Co.,Ltd	ピュアオンジャパン株式会社
神津精機株式会社	株式会社フォトニックラティス
株式会社斉藤光学製作所	不二越機械工業株式会社
株式会社サミットスーパーアブレーション	株式会社フジミインコーポレーテッド
三桜工業株式会社	合同会社ブリマテック
／次世代半導体基板のための実用加工技術検討会	Mipox株式会社
JFEテクノリサーチ株式会社	株式会社牧野フライス製作所
株式会社ジェイテックコーポレーション	ムサシノ電子株式会社
株式会社ジェイテクトグライディングツール	／株式会社ニューメタルス エンド ケミカルス コーポレーション
株式会社ジェイテクトマシニングシステム	株式会社安永 新製品
SHANDONG JINMENG NEW MATERIAL CO., LTD.	LINSHU DONGSHENG ABRASIVE CO.,LTD
秀和工業株式会社	レーザーテック株式会社
シンコー株式会社	株式会社レゾナック
Zigong Fengrui abrasive Co.,Ltd.	六甲電子株式会社
Semi Glory Electronics Materials Co., Ltd.	Huai'an Litai Silicon Carbide Micro Powder Co., Ltd
/ LONGTECH PRECISION MACHINERY CO., LTD.	

お申込方法

出展を希望される方は、公式 Web サイトの出展申込フォームより必要項目をお申込みください。

出展申込締切 2026年9月30日(水)

出展申込後のキャンセルは原則としてお受けできません。ただし主催者がやむをえないと判断した場合、下記のキャンセル料をお支払いいただきキャンセルとします。

書面によるキャンセルの意思表示の期間	2026年9月30日まで出展料の 50%	2026年10月1日以降出展料の 100%
--------------------	----------------------	-----------------------

お申込・お問合せ

産経新聞社 事業本部 コンベンション事業部 「先進パワー半導体ウエハ加工技術展 2027」事務局

〒100-8079 東京都千代田区大手町1-7-2 TEL. 03-3273-6180 FAX. 03-3241-4999 E-mail : sicgan@sankei.co.jp

